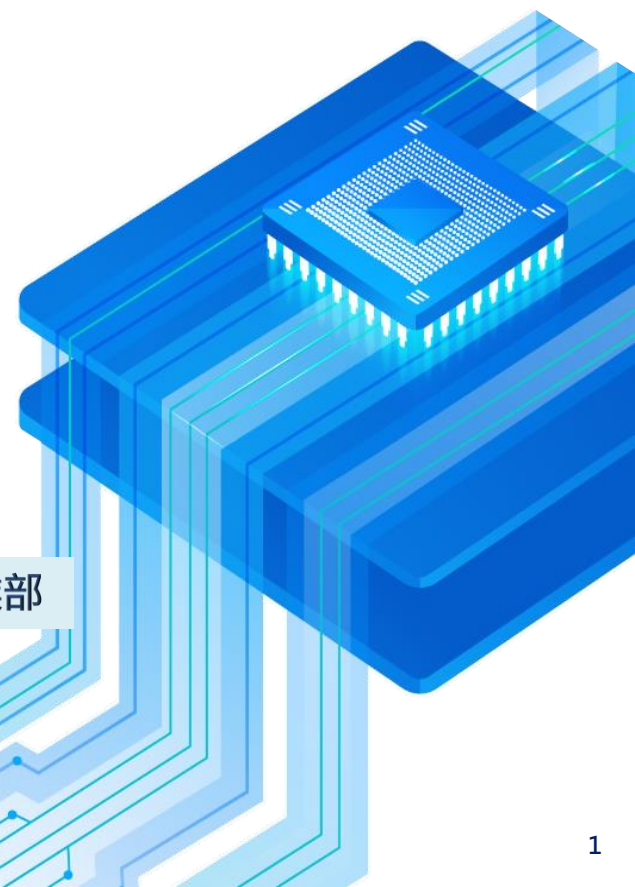


# 晶片驅動 臺灣產業創新方案

( 晶創臺灣方案，第一期 113-117年 )

參與部會：國科會、國發會、經濟部、教育部、數位部、衛福部、農業部

報告人：科技辦公室/王英裕組主任  
112年11月02日



# 晶創臺灣方案布局未來科技國力

臺灣晶圓製造、封測全球No.1的下一步

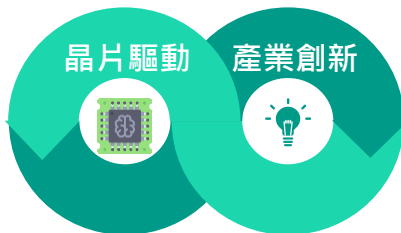
## 趨勢

地緣政治  
改變國際競合關係

各國競逐  
掌握半導體產業

生成式AI  
引發新工業革命

## 晶創臺灣方案



### 四大策略布局

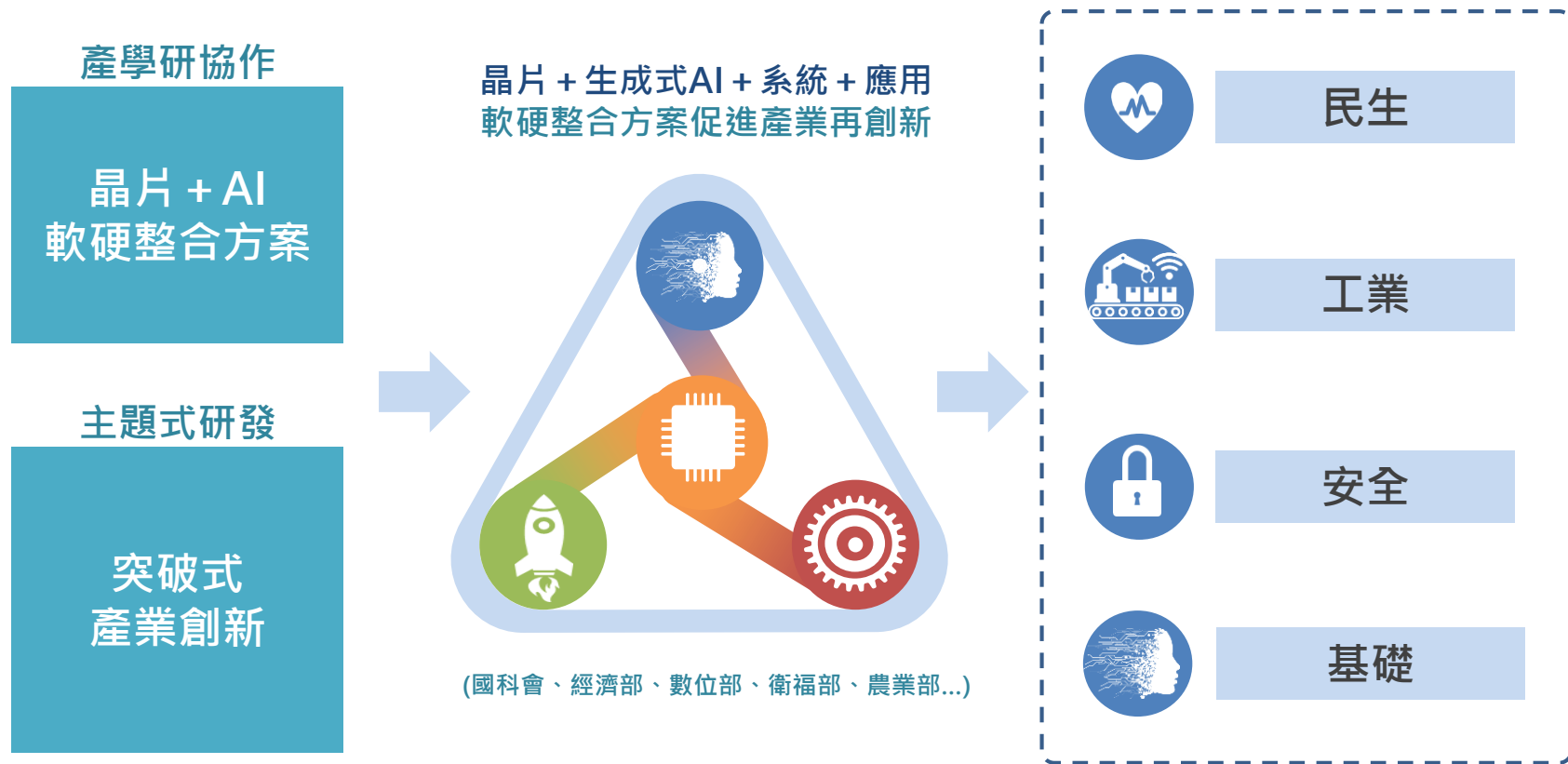
- 一 結合生成式AI+晶片  
帶動全產業創新
- 二 強化國內培育環境  
吸納全球研發人才
- 三 加速產業創新所需  
異質整合及先進技術
- 四 利用矽島實力吸引  
國際新創與投資來臺

## 願景

掌握晶片與生成式AI變革  
驅動全產業超高速創新

培育、引進晶片人才與新創  
奠基10-20年後的科技國力

# 布局一：結合生成式AI+晶片帶動全產業創新



# 布局二：強化國內培育環境吸納全球研發人才

## 強化培育環境

## 廣納全球人才

結合優秀教師與資深業師組成「晶創特聘專家團」

### 國科會統籌

升級學研機構基礎設備與軟體

產學合作提升先進晶片設計教學

產學研串接IC專業資源與服務

科、經、教

教、經

科、經

全球頂尖C設計訓練基地

就學

實習

受訓

就業

先修

### 國際攬才

(國科會、教育部、經濟部)

1. 設置海外基地與具IC設計潛力之學研機構合作
2. 產學研合作赴海外招募潛力學生與人才

未來成為產業海外布局人才

# 布局三：加速產業創新所需異質整合及先進技術

## 把握領先黃金時期，加速邁向先進製程

晶片設計端

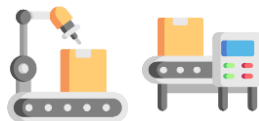
元件製造及封測端

應用端

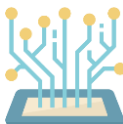
掌握關鍵晶片  
設計軟體技術



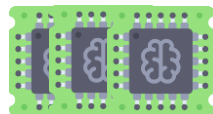
加速矽製程<1nm技術  
與非矽基晶片製造



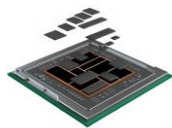
提升先進晶片  
設計能力



3D晶片堆疊技術  
與異質整合封裝



加速異質整合  
設計及介面



高算力



高頻率

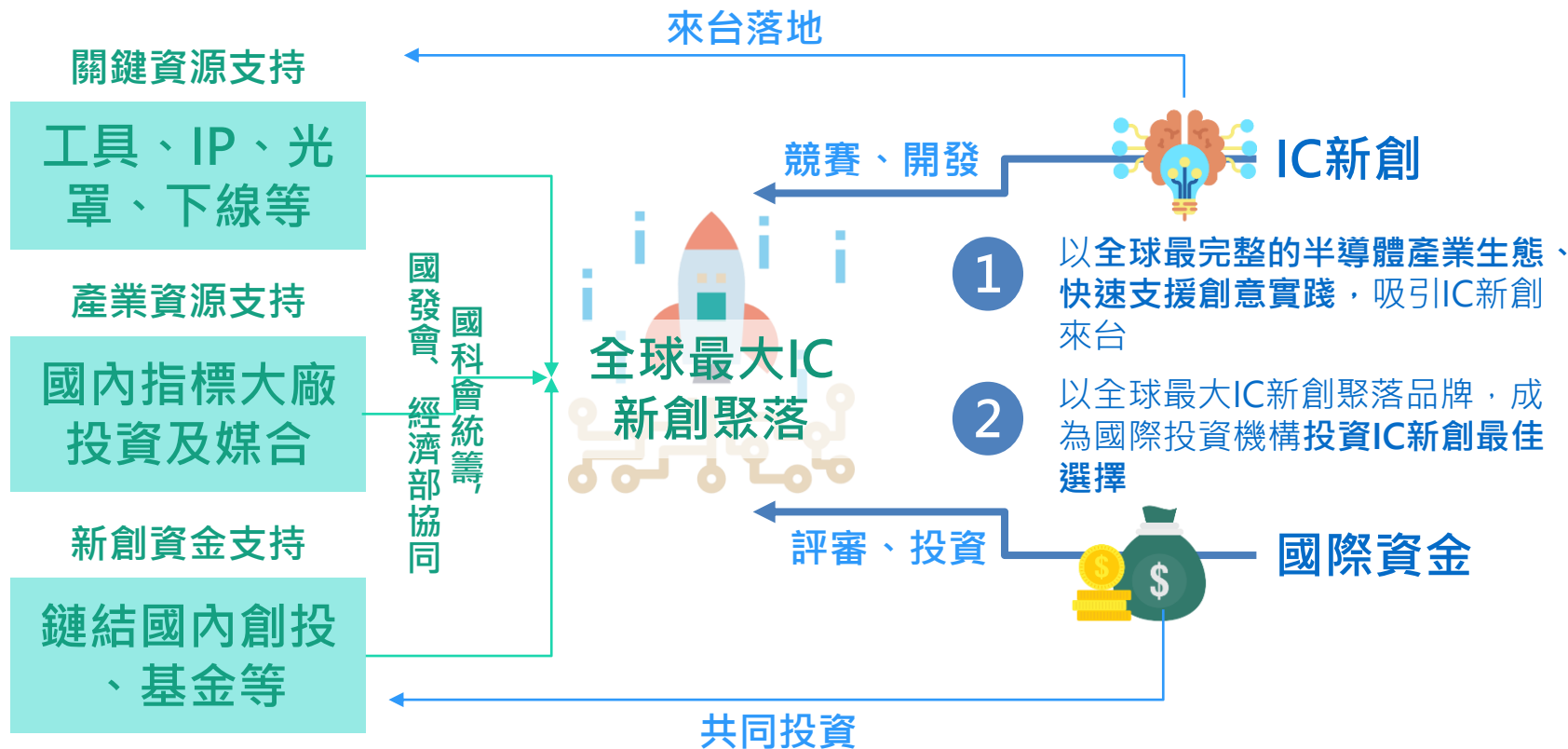


高功率



高節能

# 布局四：利用矽島實力吸引國際新創與投資來台



簡報完畢  
敬請指教